



kingston.com/emcp

eMCP

非常适合空间受限的移动、物联网和嵌入式应用的高能效集成存储解决方案

金士顿提供一系列的 JEDEC 标准 eMCP 组件。eMCP 将 Embedded MultiMedia Card (eMMC) 存储和 Low-Power Double Data Rate (LPDDR) DRAM 集成到多芯片封装 (MCP)，占用空间小。这款解决方案提供更高的集成度，降低了总体尺寸。eMCP 是非常适合智能手机、平板电脑、可穿戴设备和各种“物联网”(IoT) 设备等空间有限系统的存储与内存组合组件。

主要优势

- 管理的 NAND 闪存解决方案，利用行业标准 eMMC 接口简化了设计与产品支持。这大幅降低了设计复杂性和缩短了认证周期。
- 这种高度集成的内存与存储组合降低了系统设计的空间，使 eMCP 成为小尺寸应用的理想解决方案。
- 低功耗 DRAM 降低整体功耗，令 eMCP 成为可穿戴设备和移动物联网 (IoT) 产品等众多电池供电应用的最优解决方案。
- 通过减少组件数量降低了物料清单复杂性。
- 多种固件配置可用，完美匹配应用对性能、功耗和寿命的要求。

市场细分



智能手机和平板电脑



可穿戴设备



人工智能加速器



物联网 (IoT)

eMCP 产品型号和规格

基于 LPDDR3 的 eMCP

产品型号	存储容量		标准		封装尺寸	FBGA	工作温度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C 至 +85°C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C 至 +85°C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C 至 +85°C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C 至 +85°C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25°C 至 +85°C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.1	221	-25°C 至 +85°C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.1	221	-25°C 至 +85°C

基于 LPDDR4x 的 eMCP

产品型号	存储容量		标准		封装尺寸	FBGA	工作温度
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	149	-25°C 至 +85°C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C 至 +85°C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C 至 +85°C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C 至 +85°C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25°C 至 +85°C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.1	254	-25°C 至 +85°C

